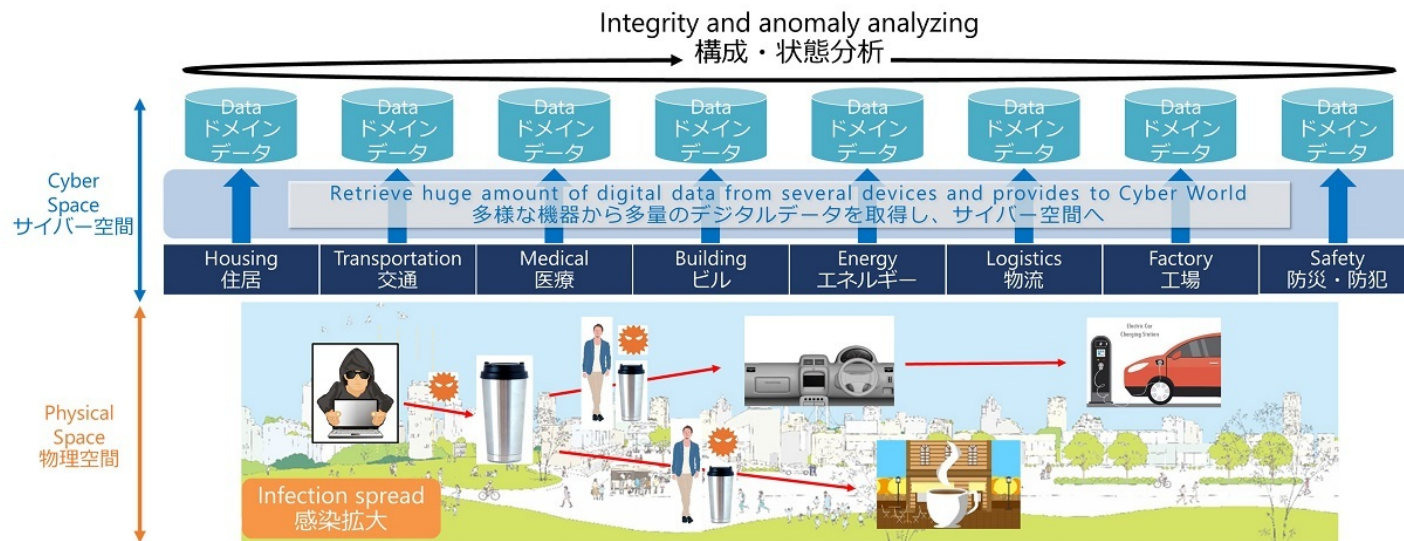




Smart Worldへのサイバー攻撃の被害を未然に防ぎます

概要

Smart Worldでは多種多様なデバイスがさまざまなサービスと繋がるため、マルウェアの感染拡大等のリスクが高まります。本技術はヒトやモノのデジタルツインを構成・状態分析技術を用いて分析することにより、Smart Worldにおける人々の活動と人々を取り巻くモノや環境の安心安全を確保します。



This work is supported by the Cabinet Office (CAO), Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP), "Cyber Physical Security for IoT Society" (funding agency: NEDO).
 本研究開発の一部は、内閣府が進める戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」(管理法人: NEDO) にて実施されています。

出展社

日本電信電話株式会社

特徴

- ヒトやモノの構成・状態をそれらの関係性を含め空間的、時間的に精緻に把握
- クロスドメイン分析によってサービス横断的な感染拡大を先回りして発見

利用シーン

- Smart Worldを構成する大量のデバイスの中から感染拡大の予兆を発見
- 感染したデバイスと同様の脆弱性を持つデバイスを発見し、感染拡大を防止

今後の展開

- 2021年度以降に構成・状態分析技術の技術検証システムを作成し、実証実験により技術確立に向けた課題抽出を行う予定です。

コラボレーションパートナー

- 本研究開発の一部は三菱電機株式会社と共同で実施しています。

問い合わせ先:
 rdforum-sv-ml@hco.ntt.co.jp